

## はんだ付される電気および電子組立品に関する要求事項： 宇宙・軍事用途向け追加規格

### 目次

本追加規格では、以下の項目について記載している。

- 0.1 適用範囲
  - 0.1.1 目的
  - 0.1.2 優先
  - 0.1.3 既存設計品または承認済み設計品
  - 0.1.4 使用
  - 0.1.5 赤疹腐食（銅の酸化腐食）
  - 0.1.6 材料および工程のトレーサビリティ

「表1 宇宙および軍事用途における要求事項」の目次

1.1	適用範囲
1.2	目的
1.5.3.2	高周波の使用
1.5.3.3	高電圧の使用
1.6.2	統計的工程管理
1.7	優先順位
1.10	要員の力量
1.11	許容に関する要求事項
1.12.2	検査
3.1	材料
3.2	はんだ
3.2.1	はんだ - Pbフリー
3.3	フラックス
3.6.1	部品およびシール部の損傷
4.3	部品表面処理の除去
4.3.1	金の除去
4.5	はんだ付性不良部品のリワーク
4.7	部品実装に関する一般要求事項
4.7.2	リードの変形限度
4.13.3	乾燥 / 脱気
4.15.1	露出面
4.15.2	はんだ接続部の異常
4.15.3	部分的に目視可または隠れたはんだ接続部
5.1.2	より線の損傷
5.3.6	端子の取付け - はんだ付
5.5	端子へのはんだ付

5.6.3	ワイヤーの固定（ステーキング）
6.1	スルーホール 端子接続 - 一般概要
6.1.1	リードの成形
6.1.2	端子接続要求事項
6.2.2	挿入実装部品リードのはんだ付
6.3.1	めっき無しホールのリード接続の要求事項
7.0	部品の表面実装
7.1.2	リード成形
7.1.3	リードの変形
7.5.5	円筒形エンドキャップ電極
7.5.6	キャストレーション（壁面溝付き）電極
7.5.7	フラットガルウイングリード
7.5.8	丸径または平坦化（つぶし加工）されたガルウイングリード
7.5.14	表面実装エリアアレイパッケージ
7.5.15	下面電極部品（BTC）
7.5.16	下面サーマルプレーン電極部品（D-Pak）
7.5.17	平坦化ポスト電極
7.5.19	外向きL形リード端子付き直立円筒キャンタイプ
7.5.20	巻付けのある端子
8.0	洗浄および残さに関する要求事項
8.1	製造工程の認定
8.1.1	洗浄識別子
8.3.1	レベル1 - 検証を必要とするメジャーな変更
8.4	異物破片（FOD）
8.5	目視可能な残さ
9.1.1	ブリスタリング（膨れ）/ デラミネーション（層間剥離）
9.1.2	繊維露出 / カットファイバー
9.1.9	焼け
9.1.11	ミーズリング
10.0	コーティング、封止、固定（接着）
10.1.3	適用
10.1.11	リワークまたは修正
10.3.1.2	固定 - 適用 - SMT
10.4 [新規]	固定（接着）
12.2	リペア